

研讨会

HFSS在终端解决方案及HFSS更新介绍

吴紫玉

Ansys中国高级应用工程师

日期：2026年10月23日

时间：下午2时 - 下午4时

地点：香港城市大学刘鸣炜学术楼15楼15-202室

摘要

随着终端产品向5G/6G、高频高速和高度集成化发展，HFSS持续推出创新求解与建模技术。其中，3D Component Array显著提升大规模天线阵列与多天线的仿真效率，支持快速评估阵列耦合与波束性能；Flex Mesh通过自适应网格技术优化复杂结构求解过程，在保证精度的同时有效缩短计算时间；Mesh Fusion则结合不同网格策略优势，实现复杂终端整机模型的高效电磁分析。依托这些技术升级，HFSS在智能手机、可穿戴设备、TWS耳机及车载终端中，可更高效地完成天线设计、射频前端优化及EMC屏蔽结构评估。新功能不仅提升了大规模复杂模型的求解能力，也进一步加速了终端产品研发流程，为企业实现更快设计迭代和更高产品竞争力提供有力支撑。

个人简介

吴紫玉 毕业于电子科技大学，获工学硕士学位。现任Ansys中国高级应用工程师，负责Ansys高频产品线的方案开发、咨询与技术支持工作。从事通信天线研发、终端天线（手机、平板、路由）研发多年，具有多种形态天线开发经验。

查询：

陈家辉博士，太赫兹及毫米波全国重点实验室，香港城市大学

电邮: kfaichan@cityu.edu.hk